

半導體先進製程與設備模擬 種子師資培訓班

■ 課程簡介：

在經濟部產業專業人才發展推動計畫指導下，為協助推動技專校院人才發展計畫，培育人才，盼藉由半導體先進製程與設備模擬種子師資培訓班，邀請對半導體製程技術與設備有研究的老師，透過課程了解半導體先進製程與設備分析對於產業界的幫助，並以 COMSOL Multiphysics 軟體來模擬演練，期能有助於教師從培訓課程的設計及經驗，導入業界人才需求之課程，以提升學生實務之教學品質。本次課程針對多重物理量耦合軟體 COMSOL Multiphysics 軟體來模擬解決方案，協助製程/設備開發。歡迎對半導體先進製程與設備模擬的大專院校教師參加。

■ 課程大綱：

112年8月30日(三)		
時間	課程大綱	講師
09:30-16:30	1. COMSOL Multiphysics 簡介及其半導體產業應用概況 2. COMSOL Multiphysics 基礎建模操作 3. 濕式蝕刻製程模擬 4. 晶片金線封裝模擬 5. 功率電晶體模擬	皮托科技專業講師群
112年8月31日(四)		
時間	課程名稱及大綱	講師
09:30-16:30	6. 化學氣相沉積模擬 7. 電漿 ICP 製程設備模擬 8. 電漿 CCP/ICP 製程設備模擬	皮托科技專業講師群

※主辦單位得因不可抗拒因素，保留本培訓班內容及講師異動之權利。

【開課資訊】

- 主辦單位：財團法人工業技術研究院
- 承辦單位：社團法人台灣電子設備協會
- 舉辦地點：台北市（實際地點請依行前通知為準）

- 舉辦日期：112 年 8 月 30-31 日(三四)09:30-16:30 (兩天共 12 小時)
- 課程費用：免費(含講義及午餐)，限大專院校相關系所教師報名，不含教職員及學生。
- 參加人員需自備筆電。
- 報名方式：



1.網碼報名：

2.請於報名後，提供教師證或名片影本 e-mail 至 vivi@teeia.org.tw，以利確認查核。

3.2 日課程皆需出席，結業時將發給教師種子師資培育時數證明。

- 報名聯絡人：

TEL：02-27293933 ext.17 楊小姐, ext.22 鄭小姐

FAX：02-27293950

E-mail：vivi@teeia.org.tw、anne@teeia.org.tw

- 注意事項：

1. 完成線上報名後，系統會發送『報名通知信』至您的 email 信箱，如未收到請來電確認。

2. 為尊重講師之智慧財產權益，恕無法提供課程講義電子檔。

3. 為配合講師時間或臨時突發事件，主辦單位有調整日期或更換講師之權利。

4. 因課前教材、講義準備，若您不克前來，請於開課三日前告知，以利行政作業進行並共同愛護資源。

- 主辦單位保留報名資格之最後審核權利。